PAT-NO:

JP02000113417A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2000113417 A

TITLE:

**MAGNETORESISTIVE HEAD** 

PUBN-DATE:

April 21, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HORIUCHI, MASATO

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

**NEC CORP** 

N/A

APPL-NO:

JP10279784

APPL-DATE:

October 1, 1998

INT-CL (IPC): G11B005/39

#### ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the breakdown of a lower gap film due to static electricity by providing a high resistance thin film pattern which electrically connect a lower magnetic shielding film and an electrode.

SOLUTION: A magnetoresistance film 1, an electrode 2 and leader lines 6a, 6b, 6c, 6d are electrically insulated from a lower magnetic shielding film 3 by a lower gap film comprising alumina or the like. A connection window 13 with an opening is formed in the lower gap film by ion milling and a high resistance thin film pattern 4 is formed in such a way that the electrode 2 and the lower magnetic shielding film 3 are connected by way of a leader terminal 5b and the leader line 6b. Tantalum nitride is used as the material of the pattern 4 and the shape is made zigzag. Even if excess electric charges are generated on the lower magnetic shielding film 3, the charges flow through the high resistance thin film pattern 4 and the leader line 6b connected to the leader terminal 5b and reach the electrode 2. The charges of static electricity are discharged.

COPYRIGHT: (C)2000, JPO

6/13/06, EAST Version: 2.0.3.0

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-113417 (P2000-113417A)

(43)公開日 平成12年4月21日(2000.4.21)

(51) Int.Cl.7

觀別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G11B 5/39

G 1 1 B 5/39

5D034

#### 請求項の数10 OL (全 8 頁) 審査謝求 有

(21)出願番号

(22)出顧日

特顯平10-279784

平成10年10月1日(1998.10.1)

(71)出顧人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 堀内 真人

茨城県真壁郡関城町関館宇大茶367の2

**茨城日本電気株式会社内** 

(74)代理人 100082935

弁理士 京本 直樹

Fターム(参考) 5D034 BA02 BA09 BA21 BB03 BB08

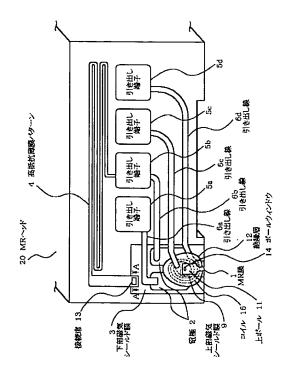
**CA07** 

## (54) 【発明の名称】 磁気抵抗効果ヘッド

#### (57)【要約】

【課題】磁性膜と下部磁気シールド膜とを電気的に絶縁 する下ギャップ膜の静電気に起因する破壊を防止したM Rヘッドを提供する。

【解決手段】下部磁気シールド膜3と電極2とを高抵抗 薄膜パターン4により電気的に接続することを特徴とす る。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 磁気抵抗効果を有する磁性膜(MR膜) と、前記磁性膜を挟む上部磁気シールド膜および下部磁気シールド膜と、前記磁性膜と前記上部磁気シールド膜 および前記下部磁気シールド膜とを各々電気的に絶縁する上ギャップ膜および下ギャップ膜と、前記磁性膜と電気的に接触し電流を供給する電極とを有する磁気抵抗効果ヘッドにおいて、前記下部磁気シールド膜と前記電極とを電気的に接続する高抵抗薄膜パターンを有することを特徴とする磁気抵抗効果ヘッド。

【請求項2】 磁気抵抗効果を有する磁性膜(MR膜)と、前記磁性膜を挟む上部磁気シールド膜および下部磁気シールド膜と、前記磁性膜と前記上部磁気シールド膜および下部磁気シールド膜とを各々電気的に絶縁する上ギャップ膜および下ギャップ膜と、前記磁性膜と電気的に接触し電流を供給する電極とを有する磁気抵抗効果へッドにおいて、前記下部磁気シールド膜と前記電極、および前記上部磁気シールド膜と前記電極とを電気的に接続する高抵抗薄膜パターンを有することを特徴とする磁気抵抗効果ヘッド。

【請求項3】 前記高抵抗薄膜パターンは、窒化タンタル (TaN) 材料で形成されることを特徴とする請求項1または2記載の磁気抵抗効果ヘッド。

【請求項4】 前記下部磁気シールド膜と前記電極、および前記上部磁気シールド膜と前記電極とを電気的に接続する前記高抵抗薄膜パターンは、共に、つづれ織り形状に形成されることを特徴とする請求項1または2記載の磁気抵抗効果ヘッド。

【請求項5】 前記下部磁気シールド膜と前記電極とを電気的に接続する前記高抵抗薄膜パターンは、一端が引き出し端子と接続され、前記引き出し端子と接続される引き出し線を介して前記電極と接続され、他端が前記下部磁気シールド膜と接続されることを特徴とする請求項1または2記載の磁気抵抗効果ヘッド。

【請求項6】 前記上部磁気シールド膜と前記電極とを電気的に接続する前記高抵抗薄膜パターンは、一端が前記引き出し端子と接続され、前記引き出し端子と接続される前記引き出し線を介して前記電極と接続され、他端が前記上部磁気シールド膜と接続されることを特徴とする請求項2記載の磁気抵抗効果ヘッド。

【請求項7】 前記高抵抗薄膜パターンと前記下部磁気シールド膜との接続部は、前記下ギャップ膜に開口部を設けた接続窓を有することを特徴とする請求項1、2、5のいずれかに記載の磁気抵抗効果ヘッド。

【請求項8】 前記接続窓は、イオンミリング工法によって形成されることを特徴とする請求項7記載の磁気抵抗効果ヘッド。

【請求項9】 前記磁性膜と前記下部磁気シールド膜と 記録媒体の磁化情報によっの間を前記高抵抗薄膜パターンにより接続することによ を電圧変化として捉えるこり、前記磁性膜と前記下部磁気シールド膜とを電気的に 50 を読み出すことができる。

絶縁する前記下ギャップ膜の静電破壊を防止することを 特徴とする請求項1記載の磁気抵抗効果ヘッド。

【請求項10】 前記磁性膜と前記下部磁気シールド膜との間、および前記磁性膜と前記上部磁気シールド膜との間を前記高抵抗薄膜パターンにより接続することにより、前記磁性膜と前記下部磁気シールド膜とを電気的に絶縁する前記下ギャップ膜、および前記磁性膜と前記上部磁気シールド膜とを電気的に絶縁する前記上ギャップ膜の静電破壊を防止することを特徴とする請求項2記載10 の磁気抵抗効果ヘッド。

#### 【発明の詳細な説明】

(0001)

【発明の属する技術分野】本発明は、磁気抵抗効果ヘッドに関し、特に、磁性膜と磁性膜を挟む上下の磁気シールド膜との間に形成され、磁性膜と上下の磁気シールド膜とを電気的に絶縁する上下のギャップ膜の静電気に起因する破壊を防止した磁気抵抗効果ヘッドに関する。

[0002]

【従来の技術】従来の磁気抵抗効果ヘッド30の概略斜 20 視図を図5に、図5の上ポール11付近を拡大して磁気 記録面から鳥瞰した概略斜視図を図6に示す。

【0003】図5および図6を参照すると、磁気抵抗効 果ヘッド30は、磁気記録媒体(図示せず)に情報を書 き込むための書き込み部と書き込まれた情報を読み出す ための読み出し部とで構成され、書き込み部は、上ポー ル11と、上部磁気シールド膜9と、コイル16と、コ イル16を上ポール11と上部磁気シールド膜9とから 絶縁するための絶縁層12と、書き込みギャップ10と から構成されており、上ポール11と上部磁気シールド 膜9とは、NiFe合金などの高透磁率・高飽和磁束密 度の磁性体材料によって形成され、ポールウィンドウ1 4において物理的に接続していて磁気回路を構成し、2 つの引き出し端子55c、55dおよび引き出し線66 c、66dを介してコイル16に電流を流すことによっ て、書き込みギャップ10において磁気回路から漏れ磁 界が生じ、その漏れ磁界によって磁気記録媒体に情報を 書き込むことができる。

【0004】一方、読み出し部は、磁性膜(以下、MR膜と称す)1と、電極2と、下部磁気シールド膜3と、40上部磁気シールド膜9と、MR膜1および電極2を下部磁気シールド膜9から絶縁するための下ギャップ膜7および上ギャップ膜8とから構成され、下部磁気シールド膜3と上部磁気シールド膜9とは、NiFe合金などの高透磁率・高飽和磁束密度の磁性体によって形成され、2つの引き出し端子55a、55bおよび引き出し線66a、66bならびに電極2を介してMR膜1に電流を流すことによって、磁気記録媒体の磁化情報によってMR膜1に生ずる抵抗変化を電圧変化として捉えることにより磁気記録媒体の情報50を読み出すことができる

【0005】また、磁気抵抗効果ヘッド(以下、MRへ ッドと称す)30は、磁気記録媒体に記録された磁化情 報を読みとるための磁気抵抗効果を有する厚さ数百オン グストロームのMR膜1と、その信号を高分解能で読み とるためにMR膜1の両側に配置された磁気シールド (下部磁気シールド膜3および上部磁気シールド膜9) を持つ構造として、MR膜1と磁気シールドとは、アル ミナなどの絶縁膜によって形成された下ギャップ膜7お よび上ギャップ膜8によって各々絶縁されているが、こ の絶縁膜が薄いほど高密度に記録された磁気情報を読み とる能力が高くなるが、現状では、磁気記録媒体の高密 度記録化に伴って、絶縁膜の厚さは0.1ミクロン以下 のレベルにまで達している。

【0006】しかしながら、絶縁膜は薄くなればなるほ ど絶縁耐圧が小さくなり、MRヘッド30における絶縁 膜の厚さレベル(0.1ミクロン程度)において、絶縁 耐圧は数十ボルトである。従って、人体や製造工程に置 かれている設備・治工具の帯電を原因として、それに近 づいたり触れたりすることによってMRヘッド30の絶 縁層が絶縁破壊を起こし、MRヘッド30が損傷し、機 20 能を失ってしまうという欠点がある。

【0007】上記不具合発生減少を防止するために、イ オナイザーをMRヘッド30や磁気ディスク装置(図示 せず)の製造工程に設置したり、人体に発生する静電気 を逃がすための工夫としてリストストラップを身に付け るなどの対策をおこなっている。しかし、MRヘッド3 0 自体が静電気に弱いという本質を持っているのに対し て、静電気はあらゆる場所に発生する可能性があるた め、絶縁破壊を完全に防ぐことはできないという欠点が ある。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】上述のように、従来の MRヘッドは、磁気記録媒体の高密度記録化に伴って、 絶縁膜の厚さが薄くなり、絶縁耐圧が小さくなり、人体 や製造工程に置かれている設備・治工具の帯電を原因と して、それに近づいたり触れたりすることによってMR ヘッドの絶縁層が絶縁破壊を起こし、MRヘッドが損傷 し、機能を失ってしまうという欠点があり、イオナイザ ーをMRヘッドや磁気ディスク装置の製造工程に設置し たり、人体に発生する静電気を逃がすための工夫として 40 リストストラップを使用する対策を施しても、MRヘッ ド自体が静電気に弱いという本質から絶縁破壊を完全に 防ぐことができないという課題がある。

【0009】本発明の目的は、下部磁気シールド膜と電 極とを高抵抗薄膜パターンにより電気的に接続するとい う簡単な構成、または、下部磁気シールド膜と電極、お よび上部磁気シールド膜と電極とを高抵抗薄膜パターン により電気的に接続するという簡単な構成により、磁性 膜と磁性膜を挟む上下の磁気シールド膜との間に形成さ

る上下のギャップ膜の静電気に起因する破壊を防止した MRヘッドを提供することにある。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】本発明のMRヘッドは、 磁気抵抗効果を有する磁性膜(MR膜)と、磁性膜を挟 む上部磁気シールド膜および下部磁気シールド膜と、磁 性膜と上部磁気シールド膜および下部磁気シールド膜と を各々電気的に絶縁する上ギャップ膜および下ギャップ 膜と、磁性膜と電気的に接触し電流を供給する電極とを 10 有する磁気抵抗効果ヘッドにおいて、下部磁気シールド 膜と電極とを電気的に接続する高抵抗薄膜パターンを有 することを特徴とする。

【0011】磁気抵抗効果を有する磁性膜 (MR膜)

と、磁性膜を挟む上部磁気シールド膜および下部磁気シ ールド膜と、磁性膜と上部磁気シールド膜および下部磁 気シールド膜とを各々電気的に絶縁する上ギャップ膜お よび下ギャップ膜と、磁性膜と電気的に接触し電流を供 給する電極とを有する磁気抵抗効果ヘッドにおいて、下 部磁気シールド膜と電極、および上部磁気シールド膜と 電極とを電気的に接続する高抵抗薄膜パターンを有する ことを特徴とする。

【0012】高抵抗薄膜パターンは、窒化タンタル (T aN) 材料で形成されることを特徴とする。

【0013】下部磁気シールド膜と電極、および上部磁 気シールド膜と電極とを電気的に接続する高抵抗薄膜パ ターンは、共に、つづれ織り形状に形成されることを特 徴とする。

【0014】下部磁気シールド膜と電極とを電気的に接 続する高抵抗薄膜パターンは、一端が引き出し端子と接 30 続され、引き出し端子と接続される引き出し線を介して 電極と接続され、他端が下部磁気シールド膜と接続され ることを特徴とする。

【0015】上部磁気シールド膜と電極とを電気的に接 続する高抵抗薄膜パターンは、一端が引き出し端子と接 続され、引き出し端子と接続される引き出し線を介して 電極と接続され、他端が上部磁気シールド膜と接続され ることを特徴とする。

【0016】高抵抗薄膜パターンと下部磁気シールド膜 との接続部は、下ギャップ膜に開口部を設けた接続窓を 有することを特徴とする。

【0017】接続窓は、イオンミリング工法によって形 成されることを特徴とする。

【0018】磁性膜と下部磁気シールド膜との間を高抵 抗薄膜パターンにより接続することにより、磁性膜と下 部磁気シールド膜とを電気的に絶縁する下ギャップ膜の 静電破壊を防止することを特徴とする。

【0019】磁性膜と下部磁気シールド膜との間、およ び磁性膜と上部磁気シールド膜との間を高抵抗薄膜パタ ーンにより接続することにより、磁性膜と下部磁気シー れ、磁性膜と上下の磁気シールド膜とを電気的に絶縁す 50 ルド膜とを電気的に絶縁する下ギャップ膜、および磁性

膜と上部磁気シールド膜とを電気的に絶縁する上ギャッ プ膜の静電破壊を防止することを特徴とする。

[0020]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態につい て図面を参照して説明する。

【0021】図1は、本発明のMRヘッド20の第一の 実施の形態を示す概略斜視図であり、図2は、図1の断 面AAの斜視図である。なお、図5、および図6に示す 従来のMRヘッド30の構成要素と同一の構成要素に関 しては、同一符号を付与している。また、図1の上ポー 10 ル11付近を拡大して磁気記録面から鳥瞰した概略斜視 図に関しては、図6と同一となるため、省略している。 【0022】図1、および図2を参照すると、本発明の MRヘッド20は、磁気記録媒体(図示せず)に情報を 書き込むための書き込み部と、書き込まれた情報を読み 出すための読み出し部とで構成され、書き込み部は、上 ポール11と、上部磁気シールド膜9と、コイル16 と、コイル16を上ポール11と上部磁気シールド膜9 とから絶縁するための絶縁層12と、書き込みギャップ 10とで構成され、読み出し部は、磁気抵抗効果を有す 20 る磁性膜(MR膜)1と、磁性膜1を挟む上部磁気シー ルド膜9および下部磁気シールド膜3と、磁性膜1と上 部磁気シールド膜9および下部磁気シールド3膜とを各 々電気的に絶縁する上ギャップ膜8および下ギャップ膜 7と、磁性膜1と電気的に接触し電流を供給する電極2 と、下部磁気シールド膜3と電極2とを電気的に接続す る高抵抗薄膜パターン4とから構成されている。

【0023】また、高抵抗薄膜パターン4は、つづれ織 り形状に、窒化タンタル(TaN)材料で形成されてお り、一端が引き出し端子5bと接続され、引き出し端子 5bと接続される引き出し線6bを介して電極2と接続 され、他端が下ギャップ膜7に開口部を設けた接続窓1 3部で下部磁気シールド膜3と接続されている。

【0024】上述のように構成された本発明のMRへッ ド20の磁気記録媒体への情報の書き込み、および、読 み出し動作について説明する。

【0025】まず、書き込みは、上ポール11と上部磁 気シールド膜9とが、NiFe合金などの高透磁率・高 飽和磁束密度の磁性体材料によって形成され、ポールウ ィンドウ14において物理的に接続していて磁気回路を 構成し、2つの引き出し端子5 c、5 d および引き出し 線6c、6dを介してコイル16に電流を流すことによ って、書き込みギャップ10において磁気回路から漏れ 磁界が生じ、その漏れ磁界によって磁気記録媒体に情報 の書き込みを行う。

【0026】一方、読み出しは、下部磁気シールド膜3 と上部磁気シールド膜9とが、NiFe合金などの高透 磁率・高飽和磁束密度の磁性体によって形成され、2つ の引き出し端子5 a、5 b および引き出し線6 a、6 b ならびに電極2を介してMR膜1に電流を流すことによ 50 上部磁気シールド膜9と高抵抗薄膜パターン44との接

って、磁気記録媒体の磁化情報によってMR膜1に生じ る抵抗変化を電圧変化として捉えることにより磁気記録 媒体の情報の読み出しを行う。

【0027】本発明のMRヘッド20は、MR膜1が、 電極2および引き出し線6 bを介して引き出し端子5 b に電気的に接続されている。このとき、MR膜1に直列 につながる電極2および引き出し線66の抵抗値はでき るだけ小さい方が好ましく、数オームの抵抗値になるよ うに設計・製造されている。

【0028】一方、MR膜1、電極2、引き出し線6 a、6b、6c、6dと下部磁気シールド膜3とはアル ミナなどで作成した下ギャップ膜7によって電気的に絶 縁されているが、図2に示すように、下ギャップ膜7に 開口部を有する接続窓13をイオンミリングによって形 成し、引き出し端子5b、引き出し線6bを介して電極 2と下部磁気シールド膜3とを接続するように高抵抗薄 膜パターン4が形成されている。

【0029】たとえば、高抵抗薄膜パターン4の材料と して、ハイブリッドICの抵抗体として使用される窒化 タンタル(TaN)を使用しており、その比抵抗はおよ **そ300μΩ・cmであるから、膜厚100オングスト** ローム、幅3ミクロンの高抵抗薄膜パターン4を形成し た場合、1 c mの長さのパターンを作ることによって、 1 MΩの抵抗を得ることができる。スライダ15の幅は 1mm程度であるから、図1に示すごとく、高抵抗薄膜 パターン4の形状を、つづれ織り形状パターンとしてい るため、幅数十ミクロンのパターンエリアで1MΩ以上 の抵抗となる高抵抗薄膜パターン4を形成することがで きる。

【0030】上述のように、MR膜1もしくは電極2が 下部磁気シールド膜3と高抵抗薄膜パターン4によって 接続されることにより、MRヘッド20は、MR膜1と 下部磁気シールド膜3とを高抵抗で接続する回路を有す ることになり、MRヘッド20の周囲に存在する人体や 設備・治具・梱包材などによってもたらされ得る過剰な 電荷が下部磁気シールド膜3に発生したとしても、高抵 抗薄膜パターン4を通り、引き出し端子56に接続され ている引き出し線66、電極2へと電気的に導通があ り、静電気の電荷は充電されることなく放電されること になる。

【0031】また、高抵抗薄膜パターン4の抵抗値が充 分大きいので、本来のMRヘッド20の機能であるとこ ろのMR膜1の抵抗変化に基づく電圧変化は、高抵抗薄 膜パターン4によってほとんど影響を受けない。

【0032】次に、本発明のMRヘッド21の第二の実 施の形態について図面を参照して説明する。

【0033】図3は、本発明のMRヘッド21の第二の 実施の形態を示す概略斜視図、図4は、図3に示すMR ヘッド21の絶縁層12、コイル16の一部を破断し、

6/13/06, EAST Version: 2.0.3.0

続を示す拡大図である。なお、第一の実施の形態を示す MRヘッド20を示す図1、図2の構成要素と同一の構 成要素に関しては、同一符号を付与している。

【0034】図3、および図4を参照すると、MRへッド21は、磁気抵抗効果を有する磁性膜(MR膜)1と、磁性膜1を挟む上部磁気シールド膜9および下部磁気シールド膜3と、磁性膜1と上部磁気シールド膜9および下部磁気シールド膜3とを各々電気的に絶縁する上ギャップ膜8および下ギャップ膜7と、磁性膜1と電気的に接触し電流を供給する電極2と、下部磁気シールド 10膜3と電極2とを電気的に接続する高抵抗薄膜パターン4と、上部磁気シールド膜9と電極2とを電気的に接続する高抵抗薄膜パターン44とから構成され、下部磁気シールド膜3と電極2、および上部磁気シールド膜9と電極2とを電気的に接続する高抵抗薄膜パターン4、44は、共に、つづれ織り形状に、窒化タンタル(TaN)材料で形成されている。

【0035】下部磁気シールド膜3と電極2とを電気的に接続する高抵抗薄膜パターン4は、一端が引き出し端子5bと接続され、引き出し端子5bと接続される引き出し線6bを介して電極2と接続され、他端が下ギャップ膜7に開口部を設けた接続窓13部で下部磁気シールド膜3と接続され、上部磁気シールド膜9と電極2とを電気的に接続する高抵抗薄膜パターンは44は、一端が引き出し端子5bと接続され、引き出し端子5bと接続される引き出し線6bを介して電極2と接続され、他端が上部磁気シールド膜9と接続部18にて接続されている。

【0036】上述のように構成されたMRへッド21の 磁気記録媒体への情報の書き込み、および、読み出し動 30 作については、第一の実施の形態であるMRへッド20 と同一であるため、詳細な説明を省略する。

【0037】MRヘッド21は、電極2と下部磁気シー ルド膜3との間、および電極2と上部磁気シールド膜9 との間を各々高抵抗薄膜パターン4、44により接続す ることにより、MR膜1と下部磁気シールド膜3との 間、および、MR膜1と上部磁気シールド膜9との間を 高抵抗で接続する回路を有することになり、MRヘッド 21の周囲に存在する人体や設備・治具・梱包材などに よってもたらされ得る過剰な電荷が下部磁気シールド膜 40 3、或いは、上部磁気シールド膜9に発生したとして も、高抵抗薄膜パターン4、或いは、高抵抗薄膜パター ン44を通り、引き出し端子56に接続されている引き 出し線6 b、電極2へと電気的に導通があり、静電気の 電荷は充電されることなく放電されることになり、MR 膜1と下部磁気シールド膜3とを電気的に絶縁する下ギ ャップ膜7の静電破壊を防止でき、かつ、MR膜1と上 部磁気シールド膜9とを電気的に絶縁する上ギャップ膜 8の静電破壊をも防止することができる。

【0038】また、高抵抗薄膜パターン4、44の抵抗 50 9

値が充分大きいので、本来のMRへッド21の機能であるところのMR膜1の抵抗変化に基づく電圧変化は、高抵抗薄膜パターン4、44によってほとんど影響を受けることはない。

[0039]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の第一のMRへッドは、MR膜と下部磁気シールド膜とを高抵抗薄膜パターンにより電気的に接続するという簡単な構成により、人体や設備・治工具などによってもたらされる静電気によって、絶縁層である下ギャップ膜が破壊されることがなくなり、静電気によるダメージを除去したMRへッドを提供することができるという効果がある。

【0040】また、本発明の第二のMRへッドは、MR膜と下部磁気シールド膜およびMR膜と上部磁気シールド膜とを高抵抗薄膜パターンにより電気的に接続するという簡単な構成により、人体や設備・治工具などによってもたらされる静電気によって、絶縁層である下ギャップ膜、上ギャップ膜の両方とも、破壊されることがなく、必要最低限の静電気対策を施すだけで、静電気によるMRへッドのダメージを完全に除去することができ、MRへッドが元来有する読み出し能力を損なうことなく、静電気によるダメージを完全に除去したMRへッドを提供することができるという効果がある。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のMRヘッドの第一の実施の形態を示す 概略斜視図である。

【図2】図1の断面AAの斜視図である。

【図3】本発明のMRヘッドの第二の実施の形態を示す 概略斜視図である。

【図4】図3の一部を破断し、上部磁気シールド膜と高 抵抗薄膜パターンとの接続を示す拡大図である。

【図5】従来のMRヘッドを示す概略斜視図である。

【図6】図5に示すMRヘッドの上ポール付近を拡大して磁気記録面から鳥瞰した概略斜視図である。

#### 【符号の説明】

- 1 磁性膜 (MR膜)
- 2 電板
- 3 下部磁気シールド膜

4、44 高抵抗薄膜パターン

5a、5b 引き出し端子

5 c 、 5 d 引き出し端子

55a、55b 引き出し端子

55 c 、55 d 引き出し端子

6a、6b 引き出し線

6 c 、 6 d 引き出し線

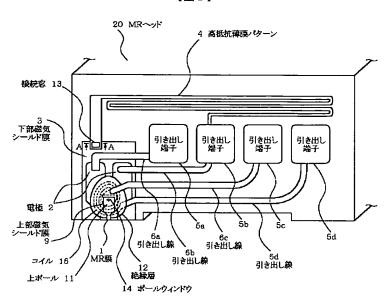
66a、66b 引き出し線

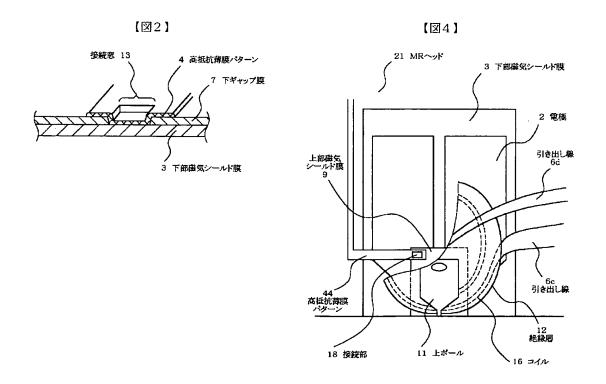
66c、66d 引き出し線

7 下ギャップ膜

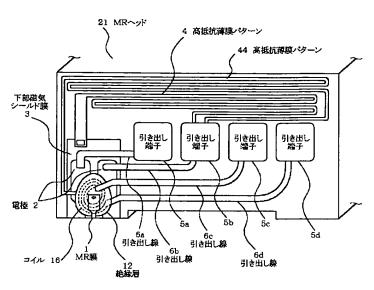
- 8 上ギャップ膜
- 0 9 上部磁気シールド膜

【図1】





【図3】



【図5】

